

THM 68导热膏

产品特征

采用有机硅为主要原料，添加耐热、导热性能优异的材料精制而成。

性能特点

- 具备良好的触变性，涂覆或灌封工艺简单便捷。
- 具有卓越的导热性能，蒸发损失和油离度较低，高温环境下不会流淌。
- 表现卓越的绝缘性能，无毒、不固化，不对基材产生腐蚀，化学性质稳定。

典型数据

项目	典型数据	实验方法
外观	白色	ASTM D156
粘度@Pa·s	542	ASTM D1092
比重	2.1	ASTM D1475
导热系数@W/m.k	0.67	ASTM D5470
流失量@120°C, 24h, %	0.23	-

典型数据为平均值，仅供参考，具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化。

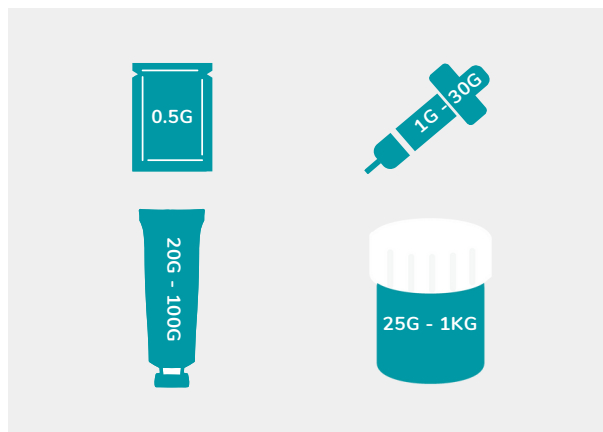
推荐应用

- 适用于将电气设备和印刷电路板组件与散热器进行热耦合。
- 使用温度范围：-50 ~ 120°C

产品储存

- 存放在室内或遮挡物下，以避免雨水或潮湿空气侵入；禁止室外存放。
- 防止包装物的外标签被侵蚀。当外标签破损不能确认品名时，不建议继续使用。
- 产品不应储存在超过 60°C或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
- 在20°C以下阴凉环境下未开封保存，自生产日期起，保质期为60个月。

包装规格



使用限制

- 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。
- 应注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
- 本产品未被测试或陈述为适合医用或药用。

“

“苛刻条件下的润滑保护”